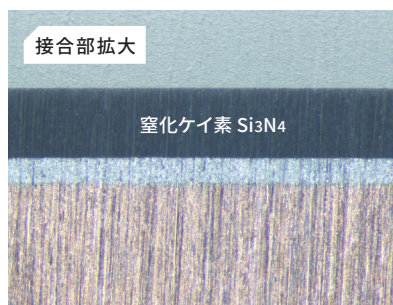
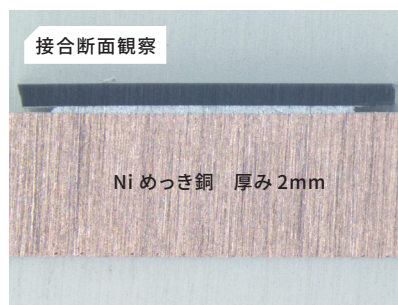
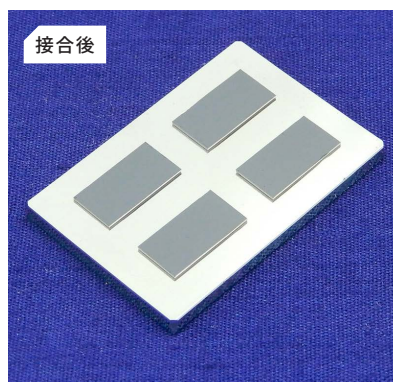
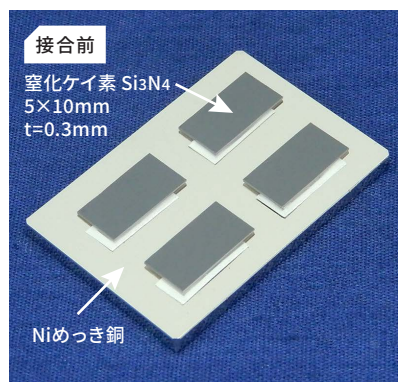




Application

Bonding ボンディング

セラミックス基板とヒートシンクのダメージのない
異材料間一括接合



Point ここがポイント

- 窒化ケイ素基板 とNiめっき銅製ヒートシンクの異材料間接合
- 4個のセラミックス基板を一括同時接合
- ヒートショックテストクリア (−50〜500℃)
- 音エネルギーのみで接合
- 大気中常温接合
- 接合のエネルギー源は電気とエア

Product used 使用する装置

- 15MZs



AP-J-0096A4-2026082601